



2025年度第1回 ガラス科学技術研究会のご案内

協賛：公益社団法人 日本セラミックス協会 ガラス部会

「半導体に用いられるガラス」

一般社団法人ニューガラスフォーラム

半導体技術の進化は、現代社会の発展に不可欠な要素となっています。その中で、ガラスは次世代の電子デバイスの性能向上や製造技術の革新に大きな影響を与える重要な材料です。今回のガラス科学技術研究会では「**半導体に用いられるガラス**」をテーマに、3名の先生方に最新の情報を講演いただきます。ガラス技術者の方に貴重な情報を提供できると思いますので、多くの方のご参加をお待ちしております。

今回のガラス科学技術研究会は対面とオンラインを組み合わせたハイブリッド方式で行います。また参加者同士の交流を深めるために、講演終了後に**技術交流会**を行いますので、ぜひご参加ください。

1. 日時：2025年7月31日（木）

講演：13:00～16:10

技術交流会：16:30～18:00

- 立食形式で、アルコール／ソフトドリンクと軽食のご提供を予定しています。
- 講師の先生方はご都合により技術交流会にご参加いただけない場合があります。

2. 場所：日本ガラス工業センター 地下会議室

住所：東京都新宿区百人町3-21-16

アクセス：JR山手線 新大久保駅から徒歩6分

(ZOOMによるオンラインと併用利用予定)

3. プログラム

3-1. 事務連絡 13:00～13:05

3-2. 開会挨拶 13:05～13:10

斎藤 全 ガラス科学技術研究会主査（愛媛大学 教授）

3-3. 講演

講演① 13:10～14:05（講演45分、質疑応答10分）

「半導体パッケージ基板としてのガラス材料」

佐竹 昇 先生（AGC株式会社 電子カンパニー A S Pプロジェクト 技術開発グループ）

【要旨】

ガラス材料は有機材料に比べて機械的・電気的特性に優れるため次世代の半導体パッケージ材料候補として近年盛んに技術開発が行われている。

AGCでは2010年台よりガラスを用いたパッケージ基板・インターポーラー向けの材料・加工開発に取り組んでおり、本講演では半導体パッケージ基板としてのガラス材料の可能性について述べる。

講演② 14:05～15:00（講演45分、質疑応答10分）

「半導体製造に用いられるシリカガラス」

葛生 伸 先生（福井大学名誉教授）

【要旨】

半導体製造には様々な形でシリカガラスが用いられている。シリカガラスには様々な種類があり、用途に応じて使い分けている。シリカガラスを使用する半導体製造プロセスについて述べたのち、シリカガラスの製造方法と製造方法による性質の違いを述べる。

----- 休憩（10分） -----

講演③ 15:10～16:05（講演45分、質疑応答10分）

「EUVリソグラフィ用マスクブランクス開発の歴史」

笑喜 勉 先生（HOYA株式会社 LSI事業部 第1技術開発部 プリンシバル）

【要旨】

EUVリソグラフィは、2019年より先端半導体デバイスの製造に適用され、さらに今後も活用・拡大が期待される技術である。本講演では、EUVリソグラフィ用のブランクスの歴史として開発初期の課題と実際の活動に触れ、ブランクス構成・材料の詳細を紹介したのち、次世代に向けた技術動向とEUVブランクスの展望を解説する。

3-4. 事務連絡 16:05～16:10

4. 研究会参加費について

- 会員企業の方 : 13,000円
- 非会員企業の方 : 25,000円
- 官学研究者の方 : 1,000円 <年間登録者無料>

<次ページに続きます>

5. 参加申込み

次の①～⑧の事項を記入の上、**2025年7月24日（木）**までにセミナー研究会窓口まで e-mail にてお申込み下さい。追って請求書を送付いたします。

- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| ① 氏名（フリガナ） | ② 所属（会社名・部署） |
| ③ E-mail アドレス | ④ 住所 |
| ⑤ TEL 番号 | ⑥ 参加を希望するセミナー・研究会名 |
| ⑦ 希望する参加方式（現地
参加または Web 参加） | ⑧ 現地参加の場合、技術交流会への
出欠 |

6. 問い合わせ先

一般社団法人ニューガラスフォーラム
セミナー研究会窓口 (yamamoto@ngf.or.jp) 担当：神吉（かんき）
〒169-0073 東京都新宿区百人町 3-21-16 日本ガラス工業センター2F
TEL:03-6279-2605 FAX:03-5389-5003

以上